

Lasertec News 13

株 主 通 信 第 5 3 期 (2014年7月1日~2015年6月30日)

レーザーテックは真のグローバル企業として
その企業価値の向上を目指してまいります。



Lasertec

Lasertec Global Operations

レーザーテックのグローバル体制

レーザーテックの売上高の50%以上は海外向けです。世界初のLSIフォトマスク欠陥検査装置を1976年に発売して以来、半導体分野を中心に世界中のリーディングカンパニーに多くの検査装置を納入し、高い評価をいただいております。

海外での体制づくりは、1980年、当時半導体事業が盛んであったドイツでの駐在員事務所開設に始まります。その後、1986年米国現地法人、2001年韓国現地法人、2005年台湾支店(2010年現地法人化)を設立し、海外のお客さまのご要望におこたえできる現地体制づくりを進めてまいりました。現在、海外拠点での従業員数は合計約70名となり、世界各地のお客さまへの装置に関するサポートを中心に、販売・マーケティング活動も展開しております。

また、2011年より欧州、北米、アジア(シンガポール、香港)において、海外機関投資家向けIR活動を継続的に実施し、世界の投資家にレーザーテックをご理解いただけるよう努めております。

『世界中のお客さまから真っ先に声をかけていただける会社になる』というビジョンの実現に向けて、海外現地法人と本社が一体となり、真のグローバル企業としての持続的な成長と企業価値の向上を目指しております。

Europe

欧州売上高

1.9%

284百万円

Japan
国内売上高
38.8%
5,886百万円

North America
北米売上高
30.0%
4,549百万円

Asia
アジア売上高
29.4%
4,467百万円

2015年6月期

海外売上高 **61.2%** **9,301** 百万円

国内売上高 **38.8%** **5,886** 百万円



新中期経営計画 第2段階が完了、 受注・利益で 過去最高額を達成

新中期経営計画の第2段階「フェーズI」(3年間)の最終年度である2015年6月期(以下当期)は、『新たな挑戦』の仕上げの年として、スタート時から進めてまいりました製品力・営業力の強化、および原価低減活動に徹底して取り組みました。その結果、前期に続いて増収・増益となり、また受注および利益では過去最高額を達成することができました。

レーザーテック株式会社 代表取締役社長

岡林 理

Q1. 当期の業績についてどう評価されますか。市場環境と併せてお話しください。

» A1. 売上では、特に半導体用マスク blanks 欠陥検査装置や FPD 用マスク欠陥検査装置が好調に推移しました。また利益面では、原価低減への継続的な取り組みの成果に加えて、製品構成の変化などもあり、過去最高額を達成することができました。

当期における半導体業界は、スマートフォン向けの半導体生産が好調で、半導体デバイスメーカー、および材料メーカーの微細化向け投資が堅調に推移しました。これにより、特にマスク blanks 欠陥検査装置が好調で、当社の半導体関連装置の売上も前期に続いて100億円を超えることができました。また FPD 業界では、中小型液晶パネルの高精細化対応への投資が行われた結果、FPD 用マスク欠陥検査装置の売上も業績に貢献しました。

このような環境下、当期の業績は、売上高151億87百万円（前連結会計年度比11.6%増）、営業利益47億22百万円（同52.5%増）、経常利益46億30百万円（同46.5%増）、当期純利益29億53百万円（同50.0%増）となりました。利益面では、原価低減などの取り組みを通じて、前連結会計年度比でそれぞれ約50%増の過去最高額を達成することができました。また受注につきましても、全社で184億4百万円（同13.7%増）となり、前期に続いて創業以来の最高額を更新いたしました。

Q2. 当期は、新中期経営計画の第2段階「フェーズI」の最終年度でした。どう評価していますか。また、今期（2016年6月期）からスタートした「フェーズII」は、どのように展開されていきますか。

» A2. 「フェーズI」では、お客さまのニーズに素早くおこたえできる新製品の開発と、各装置が使用される世界各地でのサポート体制の強化により、マーケットシェアの向上とお客さま満足度の向上が図れたと思います。今期からスタートした「フェーズII」では、長年培われた当社独自の技術力と、お客さま固有の問題を解決できるソリューションの提供で、さらなる成長を目指します。

「フェーズI」の基本方針は、「コアビジネスの強化」と「新規事業の柱を一つ立ち上げる」の二つでした。いずれも、お客さまのニーズをいち早くつかみ、必要とされる装置をスピード

開発するとともに、万全のサポート体制を国内はもちろん、米国、韓国、台湾でつくり上げてまいりました。



1) コアビジネスの強化

コアビジネスの主力製品は、半導体関連ではマスクブランクス欠陥検査装置およびマスク欠陥検査装置があり、FPD関連では高精細FPD用マスク欠陥検査装置、それに業務用顕微鏡があります。それぞれの「フェーズI」における結果は次の通りです。

マスクブランクス欠陥検査装置は、お客さまの微細化ニーズに対応した新製品開発により、高いマーケットシェアを維持することができました。ブランクスの微小欠陥管理では、半導体微細化の進展に伴いさらに高感度の検査装置が求められ、当期は最新鋭機種種の受注が好調でした。マスク欠陥検査装置では、検出感度の高さ、装置の信頼性といった製品力に加え、サポート力にも高い評価をいただきました。またFPD業界では、スマートフォンパネルの高精細化に伴う高感度マスク検査の必要性が高まり、高精細FPD用マスク欠陥検査装置の受注が増加し、売上に貢献しました。業務用顕微鏡では、2013年に発売した多機能・高分解能のOPTELIGS HYBRID顕微鏡による新たな

顧客開拓で、シェアを高めることができました。

2) 新規事業の柱を一つ立ち上げる

新規事業の柱づくりとして、半導体ウェハ関連の各種製品開発と受注活動の強化を進めてまいりました。一つ目の柱を構成する主要2製品の進捗状況は次の通りです。

まず、SiCウェハ欠陥検査/レビュー装置の成果です。営業力を強化して取り組んだ結果、国内ではほぼすべてのお客さまに採用され、業界標準機としての高い評価をいただいております。直近では、業界のリーディングカンパニーである昭和電工株式会社様とローム株式会社様での採用が決定しました。次世代パワー半導体として期待されているSiCパワーデバイスは、2017～2018年に向けて量産化が進む見込みです。当社は継続的に製品力を強化するとともに、お客さまの量産化に対応するサポート体制も構築してまいります。

もう一つのウェハ関連装置は、リソグラフィプロセス検査装置です。この装置は、微細化に伴い、従来の検査装置では検出できない欠陥などの検査ニーズに対応した製品です。検査工程での歩留まり向上に極めて有効であることが認められ、お客さまに複数台採用していただけるまでになりました。

半導体ウェハ関連事業は、当社にとって新規参入の分野でしたが、今では知名度も向上し、検査装置に関するさまざまなニーズについてお客さまから声をかけていただけるようになりました。

今期よりスタートした「フェーズⅡ」の取り組み

「フェーズⅡ」では「コアビジネスのさらなる強化」と「新規事業の二つ目の柱を立ち上げる」を目標とし、レーザーテックの新たな時代を築く大きなステージにしたいと思っています。

コアビジネスの分野に関しましては、半導体は微細化、FPDは高精細化が進み、新たなニーズが生まれてきます。そのようなお客様の

ニーズにどこよりも早くこたえられる製品開発に一層努め、さらなる強化を図ります。

新規事業の二つ目の柱としては、半導体ウェハ検査装置関連で、新しく生まれてくる市場に照準を絞って取り組みます。具体的には、微細化の進展や、新しい構造、新しい材料の採用に伴う、新たな検査ニーズから生まれる新市場開拓に取り組んでまいります。



株主さまへのメッセージをお願いいたします。

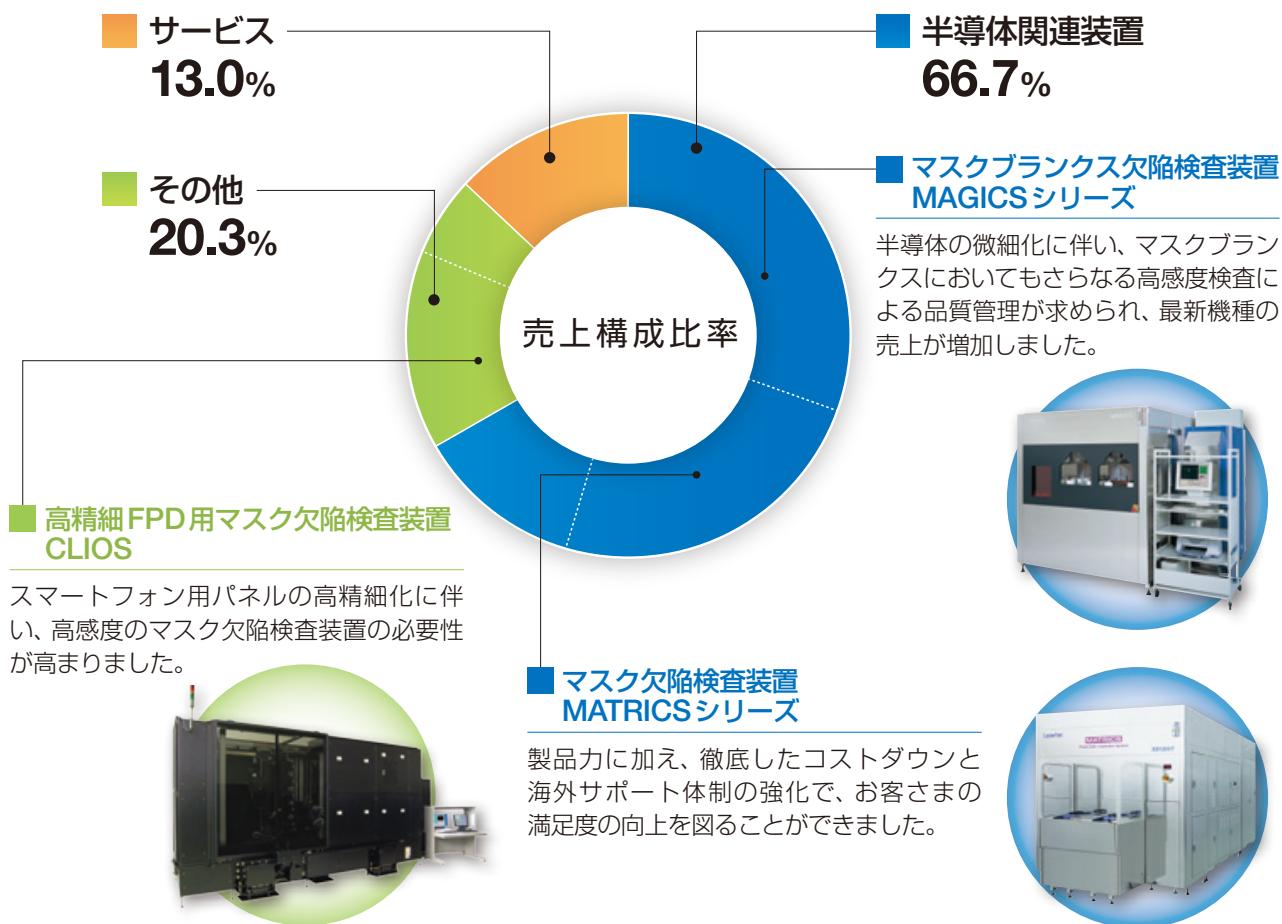
新中期経営計画がスタートした2009年は、赤字からのスタートでした。「当社の強さが発揮でき、我々が成長できる分野に経営資源を集中する」という基本方針のもと、「フェーズ0」「フェーズI」を進め、当期は、受注額と利益面で過去最高を達成することができました。ご支援に深く感謝申し上げます。また配当金につきましては、当期より、株主の皆さまへ利益還元 of さらなる充実を図るため、連結配当性向の

目安を従来の30%から35%に引き上げることといたしました。

レーザーテックはこれからも、世界中のお客様への貢献を通じて、真のグローバル企業としてその企業価値を高め、株主さまのご期待におこたえてまいりたいと存じます。今後とも、一層のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

売上を牽引する製品群

2015年6月期は、当社コアビジネスの主力製品の一つであるマスクブランクス欠陥検査装置 MAGICS シリーズの最新機種の上売が大幅に伸び、利益においても大きく貢献しました。また、スマートフォン用パネルの高精細化に伴い、高精細 FPD 用マスク欠陥検査装置 CLIOS の売上も増えました。コアビジネスを構成する以下の3製品が、当期の売上を牽引しました。



新規事業分野の活動事例

レーザーテックでは、コアビジネスであるマスクブランクス欠陥検査装置、マスク欠陥検査装置、高精細FPD用マスク欠陥検査装置、および業務用顕微鏡に加え、新規事業として半導体ウェハ関連検査装置 (WASAVIシリーズ) に力を入れています。その取り組み事例をご紹介します。

Topic

1

「電子部品・技術国際会議 (ECTC2015)」の技術展に出展

(2015年5月26日～29日)

今年5月に米国サンディエゴで開催された3次元実装などの半導体パッケージ技術に関する国際学会「電子部品・技術国際会議 (ECTC2015)」の技術展に出展し、TSV裏面研磨プロセス測定装置WASAVIシリーズ「BGM300」を紹介しました。

近年、半導体デバイスのさらなる高密度、高速動作、低消費電力化を目指し、チップを積み重ねて縦方向に回路を構築する3次元積層デバイスの実用化への取り組みが進んでいます。各チップの製造過程では、ウェハ裏面のシリコンの研磨精度の向上が求められていました。当社はここに着目し、シリコンの厚さやTSVの深さを正確に測定できる「BGM300」を開発、海外での新規顧客開拓にも力を入れています。



Topic

2

SiC ウェハ欠陥検査/レビュー装置「SICA」

昭和電工株式会社様で採用 (2015年5月28日)

SiC ウェハ表面の各種結晶欠陥のみならず内部欠陥も高感度で検出ができ、また高い解像度で欠陥を観察できる機能を併せ持つWASAVIシリーズ「SICA」は、発売以降多くのお客さまにご購入いただいております。当期は、SiC ウェハの業界リーダーである昭和電工株式会社様に、「SICA」の2台目が採用されました。同社は、世界最高水準の均一性と低欠陥性を兼ね備えた大口径SiC ウェハの量産化技術を確立し、その供給体制で定評があります。同社のさらなる品質強化に向けた取り組みの一環として、高スループットの「SICA」の最新機種が選ばれました。



連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (2015年6月30日)	前連結会計年度 (2014年6月30日)	科目	当連結会計年度 (2015年6月30日)	前連結会計年度 (2014年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	16,299	14,303	流動負債	3,421	3,997
			固定負債	188	227
			負債合計	3,610	4,224
固定資産	7,322	7,383	純資産の部		
			株主資本	19,648	17,300
資産合計	23,621	21,687	① 純資産合計	20,011	17,463
			負債純資産合計	23,621	21,687

連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2014年7月1日 至2015年6月30日)	前連結会計年度 (自2013年7月1日 至2014年6月30日)
② 売上高	15,187	13,607
売上原価	6,709	7,041
売上総利益	8,478	6,565
販売費及び一般管理費	3,755	3,467
③ 営業利益	4,722	3,097
⑤ 経常利益	4,630	3,161
③ 当期純利益	2,953	1,969

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2014年7月1日 至2015年6月30日)	前連結会計年度 (自2013年7月1日 至2014年6月30日)
④ 営業活動による キャッシュ・フロー	1,032	3,909
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 82	△ 83
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 611	△ 1,720
現金及び現金同等物の 期首残高	6,120	3,967
現金及び現金同等物の 期末残高	6,537	6,120

決算のポイント

① 純資産合計

株主資本に、その他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は、200億11百万円となりました。自己資本比率は84.6%で、引き続き財務の健全性を維持しています。またROE（自己資本当期純利益率）は、15.8%となりました。

② 売上高

マスクブランクス欠陥検査装置の売上が好調で、半導体関連装置の売上が前期に続き100億円を超えました。また、FPD用マスク欠陥検査装置も売上増加に貢献しました。

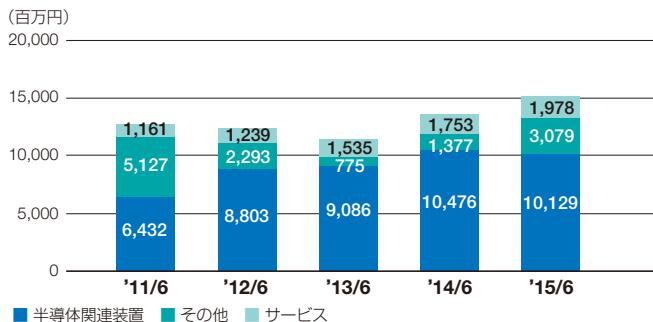
③ 利益

原価率の改善などにより、営業利益、経常利益、当期純利益が、それぞれ前連結会計年度比で約50%増加しました。

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

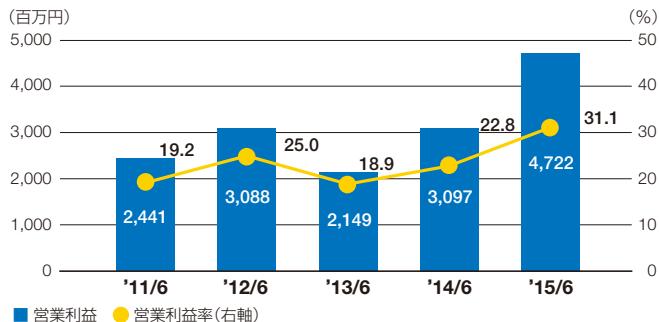
税金等調整前当期純利益などの収入要因が、売上債権の増加、法人税等の支払い、前受金の減少などの支出要因を上回りました。

製品別売上高

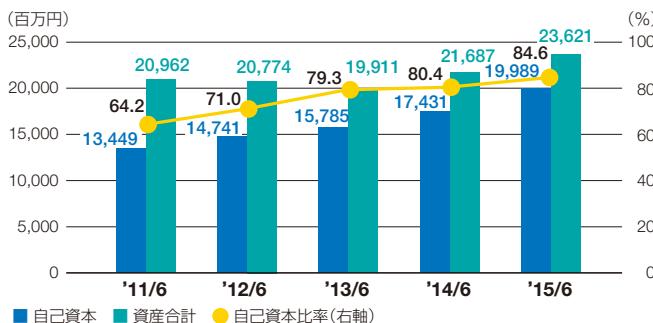


※2014年6月期より、従来のFPD関連装置およびレーザー顕微鏡の売上高は、その他とすることに変更し、2011年6月期以降の製品別売上高も遡及修正しています。

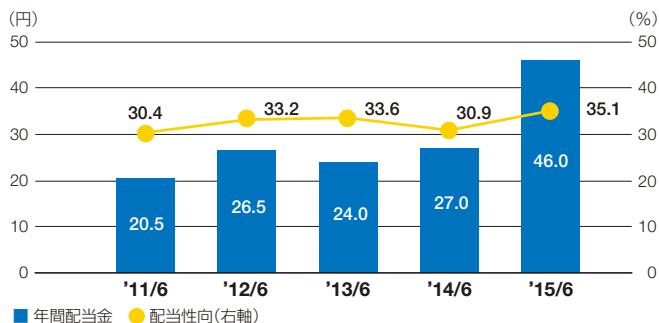
営業利益・営業利益率



自己資本・資産合計・自己資本比率

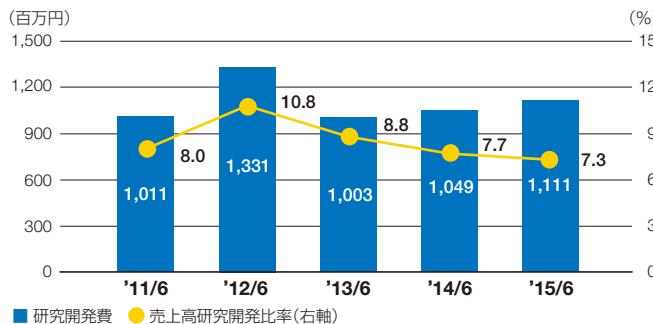


年間配当金・配当性向

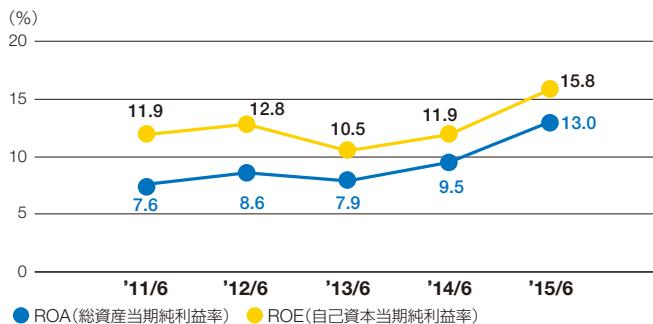


※2013年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記の数字は株式分割が2011年6月末時点で実施されたものとして計算したものです。

研究開発費・売上高研究開発比率



ROA・ROE



会社概要 (2015年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 258名 単体 190名

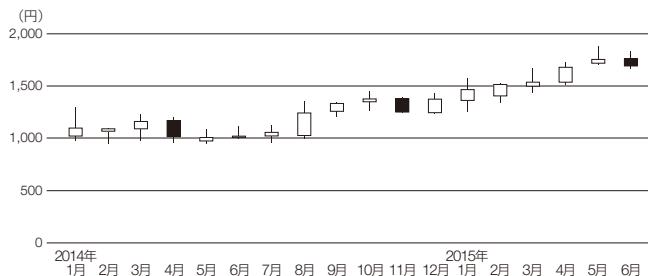
株式情報 (2015年6月30日現在)

株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部(証券コード6920)
発行済株式総数	23,571,600株
株主数	5,345名
大株主一覧	
	所有株式数(株) 持株比率(%)
内山 靖子	1,001,600 4.24
内山 洋	870,800 3.69
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	796,900 3.38
株式会社三菱東京UFJ銀行	752,000 3.19
内山 秀	697,000 2.95
THE BANK OF NEW YORK 133522	651,500 2.76
前田 せつ子	646,800 2.74
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	631,300 2.67
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL	530,200 2.24
THE BANK OF NEW YORK-JASDECTREATY ACCOUNT	527,500 2.23

(注)上記のほか、当社は発行済株式総数に対し、4.35%の自己株式を保有しています。

株価の推移



役員

(2015年9月28日現在)

代表取締役社長 岡林 理	社外取締役 梶川 信宏 海老原 稔 下山 隆之
代表取締役副社長 楠瀬 治彦	常勤監査役 古賀 一正
常務取締役 内山 秀	社外監査役 齋藤 侑二 山田 博重
取締役 森泉 幸一 関 寛和	

株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)

単元株式数	100株
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理機関	
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <http://www.Lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内

<http://www.Lasertec.co.jp>

当社Webサイトには、IR情報をはじめ各種情報が掲載されております。ぜひご覧ください。

